

## IC-Leisten RM 2,00mm, gerade/gewinkelt, 1-/2-reihig IC Headers, 2.00mm Pitch, Straight/Right-Angled, Single/Double Row

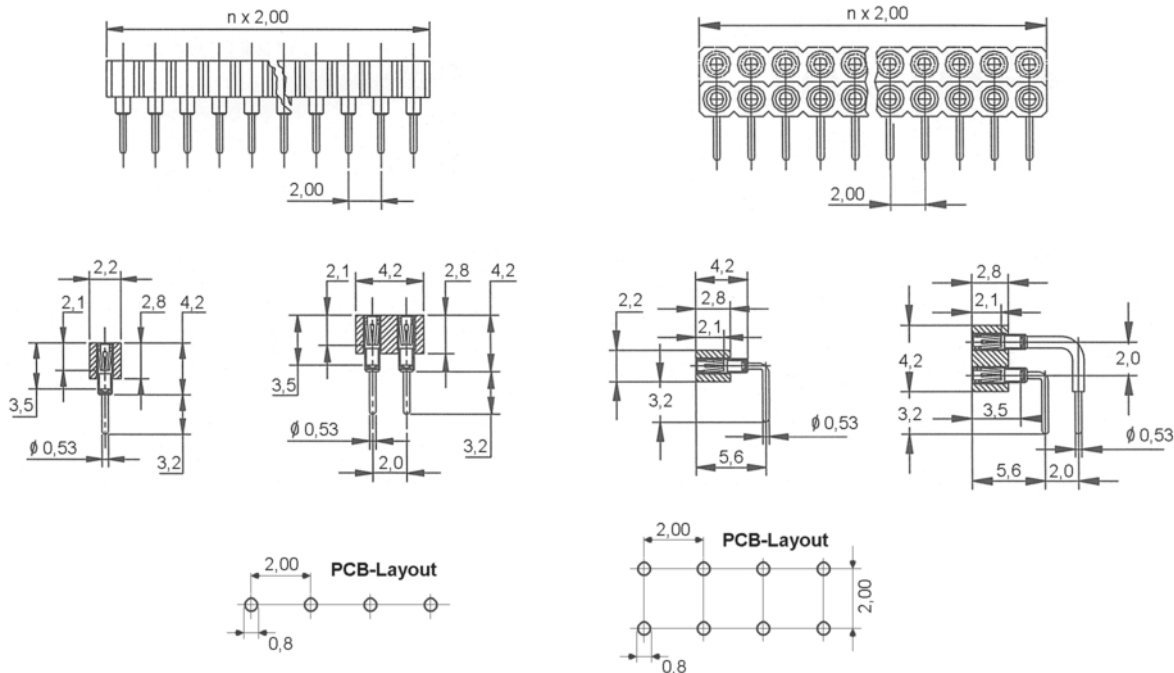
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	Sleeve: screw machined brass Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1,3 ... 2,5µm)
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 10mΩ
Contact Resistance	< 10mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1kV <sub>RMS</sub>
Test Voltage	1kV <sub>RMS</sub>
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	Wave or reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Für Rundstifte Ø 0,4 ... 0,56mm  
oder Vierkantstifte 0,25 x 0,45mm.  
For round pins Ø 0.4 ... 0.56mm  
or square pins 0.25 x 0.45mm.  
Weitere Clips siehe Option 6  
More clips please see option 6



Series	Contacts*	Type*	Sleeve Plating	Plating*	Clip (Optional)
<b>257</b>	<b>72</b> 01-64 Einreihig Single row 02-72 Zweireihig Double row	<b>4</b> 1 Einreihig, gerade Single row, straight 2 Zweireihig, gerade Double row, straight 3 Einreihig, gewinkelt Single row, right angled 4 Zweireihig, gewinkelt Double row, right angled	<b>50</b> 50 Hülse verzinkt Tin plated sleeve	<b>30</b> 00 Vergoldet Gold plated 10 Feder 0,25µm Gold 0,25µm gold plated clip 30 Feder 0,75µm Gold 0,75µm gold plated clip 50 Verzinkt Tin plated	<b>6</b> 6 6-Lamellen-Clip für Vierkantstift 0,5mm 6 Finger Clip for square pin 0,5mm

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0  
FAX +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL sales@wpro.com  
WEBSITE www.wpro.com

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

